

行業概覽

本節及本文件其他章節所載的資料及統計數據摘錄自我們委託編製的弗若斯特沙利文報告，以及各種官方政府出版物及其他公開出版物。我們委聘弗若斯特沙利文就[編纂]編製了弗若斯特沙利文報告，此為一份獨立行業報告。我們、聯席保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、彼等各自的董事及顧問，或任何其他參與[編纂]的人士或各方，均未對來自官方政府來源的資料作獨立核實，亦不對其準確性作出任何聲明。

全球及中國微納米製造市場概覽

微納米製造市場簡介

微納米製造指利用先進精密設備及技術工藝，生產微米及納米級的高精度、高複雜度及小型化功能元件及系統。微製造是指運用光刻、沉積、蝕刻、黏合及組裝等製造工藝，生產約101至1,000微米特徵尺寸的設備與結構。納米製造指運用製造工藝創造並控制約1至100納米特徵尺寸的結構。微納米製造指運用該等工藝跨兩個尺度，生產約1納米至1,000微米特徵尺寸的設備與結構。

作為微納米製造最重要的應用行業之一，全球半導體市場於2025年達到人民幣51,360億元，預計到2030年將增長至人民幣77,553億元，2026年至2030年的複合年增長率為8.1%。在半導體行業內，半導體測試耗材對於保障生產效率及良品率至關重要。憑藉微納米製造技術，該等耗材滿足了半導體生產對精度、可靠性及一致性的嚴苛要求。全球半導體測試耗材市場規模於2025年達到人民幣279億元，預計到2030年將擴大至人民幣372億元，2026年至2030年的複合年增長率為6.0%。

除半導體測試耗材市場外，微機電系統(MEMS)市場是新興微納米製造技術在半導體領域的另一重要應用領域。2025年，全球MEMS市場規模達到人民幣1,246億元，預計到2030年將增長至人民幣1,709億元，2026年至2030年的複合年增長率為6.7%。受益於其小型化、高精度及高可靠性等優勢，MEMS器件日益廣泛應用於半導體、消費電子、汽車電子等領域，推動對先進微納米製造能力的持續需求。

全球及中國微納米製造市場的驅動因素及趨勢

- **需求上升及技術升級：**來自半導體、消費電子、物聯網及人工智能的下游需求不斷增長，加上技術迭代加速，推動全球微納米製造行業的發展，並對高精度、大規模製造能力提出更高要求。

行業概覽

- **政策支持及戰略舉措：**《「十四五」製造業高質量發展規劃》等政策，以及美國國家納米技術計劃(NNI)及歐盟《芯片法案》等計劃，為研發及產業化提供支持，促進行業增長及供應鏈發展。

全球及中國微納米製造市場的准入壁壘

該行業因技術複雜性、規模要求、客戶認證及資本密集度而呈現高進入壁壘。

- **技術及製造壁壘：**微納米級生產需要先進加工、精密裝配及穩定的高良率控制。大規模生產中保持穩定品質取決於強大的工藝能力及製造經驗，形成顯著壁壘。
- **客戶認證及資源壁壘：**半導體及汽車電子等下游行業需要嚴格的認證及較長的測試週期。高昂的轉換成本帶來強大的客戶黏性，使新進入者難以進入供應鏈。

全球和中國微納米製造的波動

於往績記錄期間，微納米製造行業經歷波動，主要由於半導體週期性及原材料價格波動所致。2023年，疫情後需求調整導致全球半導體市場由2022年的5,741億美元下滑至5,270億美元，隨後在2024年反彈至6,276億美元。下游去庫存削弱了對FT探針的需求，而先前的產能擴張加劇了競爭及利潤率壓力。隨著半導體行業復甦及人工智能驅動的需求增長，市場於2024年及2025年反彈。同時，近年來銅價上漲加劇了成本壓力及盈利能力波動。

全球及中國微納米製造市場的挑戰：

- **高端設備及材料本地化率低：**中國在光刻、蝕刻系統等核心設備及材料方面仍依賴進口。國產產品在精度、穩定性及可靠性方面仍存在差距，制約了高端製造及增值能力。
- **高投資強度及市場波動：**微納米製造需要在設備及研發方面持續進行資本投入。下游需求的週期性及競爭加劇導致產能利用率不穩定及盈利能力承壓，對持續投資及創新構成挑戰。

行業概覽

全球及中國MEMS微納米製造零部件市場概覽

MEMS微納米製造零部件市場簡介

MEMS微納米製造元件是MEMS系統的基礎結構元件，MEMS系統集成了微米級機械及電子部件，以實現高精度感測、驅動及能量轉換。MEMS器件具有微型化、高集成度、智能化及低功耗的特點，廣泛應用於消費電子、汽車及物聯網領域。關鍵元件包括屏蔽蓋、微機械結構及微型連接器，為聲學、壓力及光學傳感器以及各種執行器等核心MEMS器件提供支持。

MEMS微納米製造元件的生產涉及超精密微納米級加工，因而具有較高的技術、量產、資本及認證壁壘。在全球及中國下一代消費電子、汽車電子及物聯網應用的強勁需求推動下，市場已從簡單的低精度元件向智能化、高集成度及高精度解決方案演變，從而支持行業強勁擴張。

全球及中國MEMS微納米製造零部件的市場規模

全球MEMS微納米製造零部件市場主要包括聲學模組、光學模組、壓力傳感器、慣性傳感器及其他零部件等關鍵細分領域。近年來，全球MEMS微納米製造零部件市場經歷快速擴張，2021年至2025年的複合年增長率為6.4%。2025年，全球MEMS微納米製造零部件市場收入達人民幣75億元。展望未來，市場預計保持強勁增長勢頭，2026年至2030年預測複合年增長率為6.7%。在細分市場中，聲學模組MEMS微納米製造零部件因下游需求強勁展現最高增長率，2021年至2025年實現顯著複合年增長率7.3%。MEMS聲學模組主要包括麥克風模組及微型揚聲器模組。目前，微型揚聲器零部件所佔市場份額相對較小。然而，隨著具身人工智能技術商業化，該細分領域預計呈指數級增長，成為MEMS聲學模組微納米製造元件市場擴張的關鍵驅動力。2025年，全球MEMS聲學模組微納米製造元件市場收入達人民幣11億元。預計市場將保持穩定增長，2026年至2030年期間預測複合年增長率為8.7%。

在中國對MEMS及微納米製造行業的大力政策支持、MEMS產業鏈加速國產化以及新興領域需求日益增長的推動下，中國MEMS微納米製造元件市場規模由2021年的人民幣518.4百萬元擴大至2025年的人民幣816.6百萬元，2021年至2025年的複合年增長率為12.1%。在國產智能汽車及物聯網終端等新興領域對高精度MEMS元件需求不斷增加，以及MEMS產業鏈國產化加速的支持下，市場規模預計將由2026年的人民幣920.4百萬元增長至2030年的人民幣1,542.0百萬元，2026年至2030年的複合年增長率為13.7%。

行業概覽

全球MEMS微納米製造零部件市場由多個獨立細分市場組成。各細分市場皆具備獨特技術原理及下游應用特性，如下表列示。

細分市場	聲學模組	光學模組	壓力傳感器	慣性傳感器
技術原理差異	基於微型振膜振動產生的壓電或電容效應，將聲學信號轉換為電信號。其核心為聲學信號的有效轉換及傳輸。	基於光學信號觸發的光電效應，將光學信號轉換為電信號。其核心為對光接收、反射或折射的精準處理。	基於壓力下的壓阻效應或電容變化，將物理壓力轉換為電信號。其核心為對物理壓力的精確定量轉換。	基於作用於陀螺儀或加速計的慣性力所產生的信號變化，將運動狀態轉換為電信號。其核心在於精確感知對象的運動狀態。
下游應用場景差異	專注於聲音互動及採集相關場景，主要應用於需處理聲音信號的產品，如手機麥克風、真無線耳機及智慧音箱。	專注於視覺及光學檢測相關場景，主要應用於汽車激光雷達測距、AR/VR設備的成像效果，及工業光學檢測儀器。	專注於壓力監測相關場景，主要應用於需即時監測壓力的產品，如汽車胎壓監測系統、工業管線壓力控制設備及醫療血壓計。	專注於運動及定位相關場景，主要應用於衛星姿態控制、車輛穩定系統、自動駕駛高精度定位，及工業機器人運動軌跡修正。
該領域領先企業	樓氏電子	AMS-OSRAM	WiKA	安徽芯動聯科微系統

行業龍頭與其他市場參與者之間存在明顯的策略差異。龍頭企業依賴成熟的技術、廣泛的客戶網絡及強大的財務實力，跨越多個傳感器類別（聲學、光學、壓力、慣性等）運營。相比之下，規模較小的參與者受到制約，往往專注於單一細分領域。

這種差異反映了兩大核心壁壘。首先，不同傳感器類型的客戶群差異顯著，跨領域拓展需要耗費高昂成本開拓新渠道。其次，不同類別的技術及研發路徑差異巨大，需要在研發及生產設備方面進行大量、獨立的投資。因此，資源有限的企業難以實施多元化策略。

因此，精確的競爭分析應聚焦於個別細分領域，在這些領域中，企業在可比的技術、客戶及規模維度上展開競爭。

全球MEMS聲學模組微納米製造元件市場的競爭格局

2025年，全球MEMS聲學模組微納米製造元件市場前五大參與者的集中度為66.2%。就收入而言，本公司於2025年排名第二，市場份額為12.4%。

全球及中國MEMS微納米製造元件市場的驅動因素及趨勢

- **終端應用多元化：**消費電子、汽車、醫療及智能設備的強勁需求，加上人工智能及物聯網的進步，推動市場擴張。智能家居聲學傳感器等新興應用進一步釋放新的增長機遇；
- **技術演進：**行業向智能信號處理、多傳感器集成及納米級精度發展的趨勢，得益於半導體工藝突破及供應鏈協作，並提升了MEMS的性能及應用潛力；

行業概覽

- **海外採購增長：**中國製造商在聲學及壓力傳感器等關鍵領域已實現與國際同行技術相當。在全球供應鏈重組及持續成本優化的背景下，國際下游客戶日益採用中國產的高品質元件。

全球及中國MEMS微納米製造元件市場的進入壁壘

- **技術壁壘及國產化差距：**核心工藝及設備(如光刻、蝕刻及晶圓級封裝)的國產替代有限，制約了產業突破。國產替代方案在精度、穩定性及集成能力方面存在差距，這阻礙了高端MEMS傳感器的良率及性能，並減緩了國產化及產業升級的步伐。
- **產業鏈協同不足：**上游材料及設備供應商與下游設計及應用企業之間協作薄弱，加上個別生產環節分散，延長了產品迭代週期，並降低了對快速變化的市場需求的響應能力。

微納米製造技術比較

本公司採用沖壓工藝生產其MEMS元件，並採用激光工藝製造其半導體探針。下表對比該等技術與傳統機械加工及電鍍方法。

技術名稱	優勢	劣勢
沖壓工藝	極高的量產效率，適用於大規模標準化生產。單位加工成本低且工藝穩定性佳，符合大規模標準化產品的製造需求。	模具初始投入高且工藝靈活性低。一旦產品設計改變，模具調整或更換成本高昂且週期漫長。
傳統機械加工工藝	靈活性極高，適用於複雜原型生產、小批量定製化及材料適用範圍廣泛的場景。設備准入成本低廉。	生產效率低、單位成本高，且難以實現大規模且一致的良率及精準度控制。
激光製造工藝	無需物理接觸，可加工複雜幾何形狀，良率高，且數字控制可快速切換生產任務。	設備投入高昂，處理特定高反射率材料時面臨技術挑戰，且操作維護需專業技術支援。
傳統電鍍工藝	其可在基材表面形成均勻且緻密的塗層，從而提升產品的耐磨性、耐腐蝕性及導電性。	存在環境風險及高昂的處理成本；難以精確控制塗層厚度的均勻性。

全球及中國半導體測試探針市場概覽

半導體測試探針市場簡介

半導體測試主要包括三個關鍵階段，即芯片開發過程中的設計驗證、通過芯片探測(CP)進行的晶圓級測試，以及通過最終測試(FT)進行的封裝後測試。測試探針是所有測試階段

行業概覽

的關鍵耗材，形成測試設備與芯片之間的電氣連接以評估性能。通過分析測試數據，工程師識別故障原因以優化設計、生產及封裝流程，最終提高良品率及產品質量。全球及中國半導體測試探針市場均展現強勁增長勢頭，並預計未來幾年將持續擴張。

全球及中國半導體測試探針的市場規模

近年來，全球半導體測試探針市場呈現周期性增長模式，主要受半導體行業固有波動性影響，錄得2021年至2025年複合年增長率為3.0%。2025年，全球半導體測試探針市場收入達人民幣121億元。展望未來，市場預計保持強勁增長勢頭，2026年至2030年預測複合年增長率為6.6%。在細分市場中，FT探針行業展現尤為強勁的增長勢頭。此加速主要歸因於兩大關鍵因素：人工智能計算需求激增推動GPU出貨量大增，顯著提升FT探針需求；以及先進封裝技術帶來強勁測試需求，引致探針使用率顯著上升。因此，FT探針市場錄得2021年至2025年複合年增長率為3.5%，並預計保持穩定增長，2026年至2030年期間預測複合年增長率為7.5%。

在實現半導體自給自足的政策支持、國內晶圓廠產能快速擴張、AI芯片及汽車半導體的強勁需求，以及高性能最終測試探針進口替代加速的推動下，中國FT探針市場由2021年的人民幣600.6百萬元增長至2025年的人民幣798.0百萬元，2021年至2025年的複合年增長率為7.5%。未來，在先進封裝及高算力芯片測試需求不斷提升的支持下，市場規模預計將由2026年的人民幣910.8百萬元增長至2030年的人民幣13.84億元，2026年至2030年的複合年增長率為11.0%。

全球半導體測試探針市場的競爭格局

2025年，全球半導體測試探針市場前五大參與者的集中度為33.8%。就收入而言，本公司於2025年排名第九，市場份額為2.1%。

全球半導體FT探針市場的競爭格局

2025年，全球半導體FT探針市場前五大參與者分佔合共市場份額42.9%。就收入而言，本公司於2025年排名第四，市場份額為6.6%。

行業概覽

全球及中國半導體測試探針市場的驅動因素及趨勢

- **下游需求增長：**人工智能、算力、物聯網及新能源汽車的擴張推動了半導體行業的增長。作為關鍵測試消耗品，測試探針受益於測試需求的長期上升趨勢，支持市場持續擴張。
- **技術進步帶動測試需求：**工藝節點不斷縮小（至3納米及以下）、芯粒架構的採用，以及3D及異質封裝，增加了芯片的複雜性，使測試步驟、測試點及探針用量成倍增加，從而推動了對先進探針技術的更強勁需求。
- **向高性能、智能化及自動化解決方案轉變：**測試探針正向更高頻率、更高精度及更高耐用性發展。人工智能及大數據的集成實現了自適應智能測試，而全自動探針台已成為標準配置，以提高測試效率並滿足量產要求。

全球及中國半導體FT探針市場的挑戰

- **測試技術迭代加速及研發成本上升：**向3納米／2納米先進節點的快速工藝迭代提高了對FT探針的性能要求，需要持續在研發及設備方面進行大量投入，進一步提高了行業准入門檻。
- **專業材料依賴及成本波動：**FT探針依賴於供應鏈集中的高純度合金及專用絕緣材料。材料價格及供應穩定性的波動可能對生產成本及整體盈利能力造成影響。
- **疫情後滯後效應及市場波動：**2023年的疫情後滯後效應導致半導體需求調整；下游製造商減少了對FT探針的採購，導致需求增長放緩。同時，疫情期間的產能擴張導致庫存消化壓力升高，行業競爭加劇。

全球半導體FT探針市場的進入壁壘

半導體FT探針行業具有較高的進入壁壘，主要體現在技術複雜性、客戶認證及資本密集度方面。

- **技術及製造壁壘：**FT探針的研發及生產要求高精度、工藝穩定性及跨學科專業知識。在設計、質量及工藝控制方面積累的經驗為新進入者達到所需的良率、可靠性及一致性設置了高門檻。
- **客戶認證及資源壁壘：**高端下游客戶實施嚴格的供應商認證及長週期可靠性測試。高昂的轉換成本帶來強大的客戶忠誠度，使新參與者難以獲得認證並進入供應鏈。

行業概覽

全球及中國掃地機器人微型傳動系統市場概覽

微型傳動系統定義及現狀

微型傳動系統為精密機械組件，實現緊湊空間內的動力傳輸與運動轉換。其核心組件包括微電機、齒輪，以及外殼、支架和軸承，重點追求運動控制、調速、方向調整及精度，而非單純功率輸出。

微型傳動系統廣泛應用於機器人領域，作為精密動力傳輸與運動控制的核心組件。於掃地機器人中，其實現精準移動、障礙導航及清潔路徑規劃。隨著智能清潔設備的普及率不斷上升，市場對緊湊、高效及低噪音傳動解決方案的需求加速增長。國內製造商正推進針對掃地機器人的高精度減速器與齒輪模組開發，支持性能升級及與人工智能、物聯網等智能導航技術的融合。

服務機器人概覽

機器人是用於執行任務的可編程自主系統。其可分為工業機器人、服務機器人、特種機器人及其他類型。服務機器人在各種場景中支持日常活動，包括公共服務及個人／家庭服務類型，其中掃地機器人屬於後者。

服務機器人中微型傳動系統概覽

微型傳動系統是實現服務機器人動力傳輸及運動控制的精密機械部件，掃地機器人是關鍵應用領域。廣泛應用於移動、導航及驅動，其支持緊湊設計、高效率、低噪音及耐用性。

全球及中國服務機器人市場微型傳動系統的市場規模

全球機器人市場保持強勁增長勢頭，得益於主要經濟體自動化需求上升、人工智能整合及產業升級。中國仍然是全球最大及增長最快的機器人市場，由2021年的人民幣46億元擴大至2025年的人民幣108億元，複合年增長率為23.5%，預計於2030年將增至人民幣338億元，複合年增長率為25.9%。全球市場由2021年的人民幣151億元擴大至2025年的人民幣318億元，2021年至2025年的複合年增長率為20.4%，預計於2030年將增至人民幣757億元，2026年至2030年的複合年增長率為19.1%。

中國服務機器人行業微型傳動系統的競爭格局

中國服務機器人行業微型傳動系統市場相對分散。就收入而言，前五大參與者佔23.7%的市場份額，而本公司於2025年排名第八，市場份額為1.7%。

行業概覽

全球及中國掃地機器人市場微型傳動系統的市場規模

全球掃地機器人市場微型傳動系統實現穩定增長，這得益於全球對智能家居清潔解決方案的日益普及。根據弗若斯特沙利文的資料，全球掃地機器人市場微型傳動系統由2021年的人民幣69億元增長至2025年的人民幣107億元，2021年至2025年的複合年增長率為11.6%，預計於2030年將增至人民幣231億元，2026年至2030年的複合年增長率為17.0%。中國在全球市場中佔有重要份額，由2021年的人民幣17億元擴大至2025年的人民幣27億元，複合年增長率為12.0%，預計將增長至2030年的人民幣65億元，同期複合年增長率為19.2%。

中國掃地機器人微型傳動系統行業的競爭格局

中國掃地機器人微型傳動系統市場相對集中，2025年前五大參與者的集中度為61.1%。就收入而言，本公司於2025年排名第四，市場份額為6.8%。

中國掃地機器人微型傳動系統行業的驅動因素及趨勢

- **下游應用需求持續增長：**智能家電及服務機器人的增長推動了掃地機器人對微型傳動系統的需求。家庭普及率上升及性能提升正在加速對緊湊型、高精度模塊的採用。
- **政策支持推動行業發展：**《智能製造發展規劃(2021-2025年)》等政策推動家電領域的先進製造，並支持微型傳動系統的創新，而地方激勵措施則加強了國內供應鏈。
- **向智能化與自動化系統進階：**微型傳動系統正朝著更智能、更自動化的方向發展，人工智能及傳感器的集成實現了自適應導航，並推動了對高精度解決方案的需求。

中國微型傳動系統行業面臨的挑戰

- **核心技術依賴進口：**行業在精密齒輪設計、耐用性優化等關鍵技術方面仍依賴海外參與者。國產產品儘管進步迅速，但在扭矩密度、噪音控制及可靠性方面仍存在差距，制約了升級換代及國產化。
- **成本與品質平衡難度大：**價格敏感的下游需求與精密製造的高成本形成對比。降低成本可能影響良率及可靠性，而提高品質則會增加定價壓力，使性價比成為關鍵挑戰。

中國微型傳動系統行業的進入門檻

中國微型傳動系統行業存在相對較高的進入門檻，乃受技術複雜性、規模化要求及客戶認證所推動。

行業概覽

- 實現高扭矩密度、低噪音及長使用壽命需要精密齒輪設計、微加工及高可靠性組裝方面的先進能力。穩定的大規模生產進一步依賴成熟的工藝控制及製造經驗，形成顯著的技術壁壘。
- 成本及規模經濟壁壘：下游消費機器人對價格敏感，要求具備成本競爭力。製造商依賴規模及供應鏈優化來降低成本，這使得新進入者在達到足夠規模之前難以與既有參與者匹敵。

主要原材料歷史價格走勢

過去五年，主要金屬原材料價格呈現顯著波動。總體而言，大多數金屬在疫情後復甦期經歷上漲，隨後隨著供應恢復及下游需求正常化而部分回調。展望未來，該等原材料的價格預計將在相對狹窄的區間內波動。各關鍵原料的具體發展載列如下。

- 銅：受疫情後工業及基礎設施需求快速復甦、電氣化相關應用加速、主要生產國供應中斷，以及全球流動性高度寬鬆環境下庫存水平低位的推動，全球銅價於2020年至2021年期間大幅上漲。在此次上漲之後，銅價於2021年至2023年期間總體維持在相對較高水平。2024年及2025年銅價持續上漲，主要受需求預期改善、供應限制及能源轉型需求增長的推動，預計未來將溫和上漲。2021年至2025年銅價分別為每噸人民幣60,104.7元、人民幣59,409.8元、人民幣60,122.2元、人民幣65,783.8元及人民幣71,049.6元。
- 不鏽鋼(304級熱軋不鏽鋼)：不鏽鋼價格最初大致穩定，隨後隨著製造業及耐用品需求疫情後復甦而上漲，之後隨著工業增長放緩及下游行業去庫存而回落；儘管原材料價格波動，但在多重成本結構、供給側調整及下游需求復甦的推動下，2025年不鏽鋼價格有所上漲。2021年至2025年不鏽鋼價格分別為每噸人民幣13,611.2元、人民幣19,379.5元、人民幣18,757.3元、人民幣14,362.6元及人民幣18,609.6元。預計不鏽鋼價格總體將保持區間震盪，傳統需求疲軟將被新能源及高端應用的韌性增長所抵消。
- 鎳(原生鎳)：受疫情後復甦以及不鏽鋼及電池材料強勁需求的支撐，鎳價於2021年有所上漲，隨後由於主要產區大規模產能擴張及需求增長放緩，價格自2022年至2025年有所下跌。2021年至2025年原生鎳價格分別為每噸人民幣119,127.3元、人民幣174,060.8元、人民幣152,442.4元、人民幣121,002.7元及人民幣108,962.4元。未來，由於供應充足，預計價格短期內將面臨壓力，隨著高成本產能淘汰及市場平衡改善，價格將逐步趨穩。
- 鐵礦石：隨著疫情後鋼材需求放緩及政策導向的產量控制，鐵礦石價格於2021年至2022年有所下跌，2022年至2024年因供需達到更平衡水平而保持相對穩定，2024年至2025年因房地產相關需求疲軟及海運供應充足而再次下跌。2021年至2025年

行業概覽

鐵礦石價格分別為每噸人民幣1,020.3元、人民幣812.2元、人民幣851.9元、人民幣799.3元及人民幣733.2元。未來，在鋼材需求溫和及全球供應充足的支撐下，預計價格將大致保持穩定至略微疲軟。

資料來源

就[編纂]而言，我們已委聘弗若斯特沙利文對全球及中國微納米製造市場進行詳細分析並編製行業報告。弗若斯特沙利文成立於1961年，總部設於美國，為獨立的全球市場研究及諮詢公司。弗若斯特沙利文所提供的服務包括為不同行業作出市場評估、競爭標桿分析以及策略及市場規劃。我們在本文件中載入微納米製造市場弗若斯特沙利文報告的若干資料，原因為我們認為有關資料有助於潛在[編纂]了解微納米製造市場。弗若斯特沙利文根據其內部數據庫、獨立第三方報告及知名行業組織的公開可得數據編製其報告。如有必要，弗若斯特沙利文將聯絡在該行業經營的公司，以收集及匯集有關市場及價格的資料以及其他相關資料。弗若斯特沙利文認為，編製弗若斯特沙利文報告時使用的基本假設，包括用於進行未來預測的假設，屬真實、正確且並無誤導成分。弗若斯特沙利文已獨立分析資料，但其審閱結論的準確性在很大程度上取決於所收集資料的準確性。弗若斯特沙利文的研究可能會受到該等假設的準確性以及該等一手及二手資料來源的選擇所影響。我們已同意就編製弗若斯特沙利文報告向弗若斯特沙利文支付人民幣900,000元的費用。支付有關款項並不取決於我們成功[編纂]或弗若斯特沙利文報告的內容。除弗若斯特沙利文報告外，我們並未就[編纂]委託任何其他行業報告。我們確認，在採取合理謹慎措施後，自弗若斯特沙利文編製報告之日以來，市場資料並無任何重大不利變動，足以對本節所載資料在任何重大方面造成修訂、矛盾或影響。